附件1

**重点领域任务方向表**

| **序号** | **细分领域** | **任务方向（可补充）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芯片设计与制造 | 高端芯片及新结构、新原理集成电路  先进制造工艺  先进封测技术  关键核心装备及零部件  集成电路用高端材料  ……（可补充） |  |
| 2 | 通信与网络 | 6G通信技术与关键器件  空天地海通信技术与网络  光通信技术与网络  关键核心装备及零部件  ……（可补充） |  |
| 3 | 软件与信息安全 | 操作系统  信息安全  区块链  人工智能赋能技术  专用软件  ……（可补充） |  |
| 4 | 新一代人工智能 | 智能算力硬件  模型算法  数据处理  具身智能  AI for Science  人形机器人  创新应用  ……（可补充） |  |
| 5 | 新型储能与新能源 | 氢能  风能  太阳能  核能  生物质能  海洋能  地热能  新型储能  储能装备及技术  能源电子及智慧电网  ……（可补充） |  |
| 6 | 重点新材料 | 金属材料（特种钢铁材料、铜基材料、稀土材料、磁性材料、合金材料等）  非金属材料（玻璃材料、陶瓷材料、半导体材料等）  高分子材料（化工材料、聚酯材料、高性能纤维材料、弹性体材料、涂层材料等）  复合材料（纤维增强复合材料，颗粒增强复合材料，层状复合材料，功能复合材料等）  未来材料（仿生智能材料、纳米材料、超导材料等）  材料共性技术（材料基因工程、生物制造技术、材料全生命周期设计与评价等）  ……（可补充） |  |